



[连接器](#) > [接口插槽](#) > [内存插槽](#) > [SO DIMM 插槽](#) > [DDR2 SO DIMM 插槽](#)



DRAM 类型: **双倍数据速率 (DDR)**

堆叠高度: 4 mm [.157 in]

模块方向: **直角**

位数: 200

中心线 (间距) : .6 mm [.024 in]

[所有 DDR2 SO DIMM 插槽 \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|--------------|
| 连接器系统 | 缆到板 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| DRAM 类型 | 双倍数据速率 (DDR) |

结构特性

| | |
|------|-----|
| 托架数 | 2 |
| 钥匙数 | 1 |
| 行数 | 2 |
| 模块方向 | 直角 |
| 位数 | 200 |

电气特征

| | |
|---------|-------|
| DRAM 电压 | 2.5 V |
|---------|-------|

信号特征

| | |
|----------|-------|
| SGRAM 电压 | 2.5 V |
|----------|-------|

主体特性

| | |
|--------|-----|
| 弹射器位置 | 两端 |
| 插销材料 | 不锈钢 |
| 插销电镀材料 | 锡 |

| | |
|--------|-------|
| 模块钥匙类型 | SGRAM |
|--------|-------|

| | |
|-------|----|
| 弹射器类型 | 锁定 |
|-------|----|

| | |
|-------|---|
| 连接器外形 | 低 |
|-------|---|

接触件特性

| | |
|--------|-----|
| 内存插槽类型 | 内存卡 |
|--------|-----|

| | |
|----------------|----|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 镀金 |
|----------------|----|

| | |
|------|-----|
| 端子基材 | 铜合金 |
|------|-----|

| | |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | .5 A |
|-------------|------|

| | |
|-----------|---|
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
|-----------|---|

端接特性

| | |
|------|----|
| 插入种类 | 凸轮 |
|------|----|

| | |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

| | |
|--------|------|
| 接合对准类型 | 反向键控 |
|--------|------|

| | |
|----------|----|
| PCB 安装固定 | 带有 |
|----------|----|

| | |
|------------|----|
| PCB 安装固定类型 | 焊钉 |
|------------|----|

| | |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

| | |
|------|--------|
| 外壳材料 | 高温热塑塑料 |
|------|--------|

| | |
|------|----|
| 壳体颜色 | 黑色 |
|------|----|

| | |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | .6 mm[.024 in] |
|---------|----------------|

尺寸

| | |
|------|---------------|
| 堆叠高度 | 4 mm[.157 in] |
|------|---------------|

| | |
|-----|-----------------|
| 行间距 | 7.6 mm[.299 in] |
|-----|-----------------|

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|--------|
| 封装数量 | 20 |
| 封装方法 | 半硬托盘组件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 245°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Macro Sensors PR



LVDT/LVIT 传感器(14)



固化块、固化炉和固化套(1)



引线框(6)



扩束光纤(21)



扩束光纤外壳(5)

客户还购买了



TE 产品编号1-1744524-0
EP 10P HEADER ASY NO 8 PIN



TE 产品编号1-2170704-0
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS



TE 产品编号2143329-1
1x6 QSFP Cage Assy Behind Bzl



TE 产品编号1-1542006-0
HTS210-U=HS 25MM ASSY ULTEM CL



TE 产品编号2-1542006-1
HTS512-U=HS 32.5 ASSY ULTEM CL



TE 产品编号2-1542006-3
HTS186-U=HS 21MM ASSY ULTEM CL

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6565692-1_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6565692-1_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6565692-1_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

